

株式会社フジミインコーポレーテッド 株主通信

# FUJIMI TODAY

2011.4.1~2011.9.30

vol.

# 33

2011年12月発行

## 特集 フジミの製品の優位性

つよく、やさしく、おもしろい

証券コード 5384

# FUJIMI



# We *challenging*

## 株主の皆様へ

代表取締役社長 **関 敬史**

フジミは、1950年の創業以来、表面加工分野で情報社会を支える企業として、品質の高い製品をお客様に提供してまいりました。時代とともに市場環境は変化します。しかし、当社が創業以来持ち続ける「ものづくり」の姿勢、お客様に高品質な製品を安定提供するための努力について変わることはありません。そして、当社が理想とする『強く、やさしく、面白い』会社の実現を目指して、社員一同、一層の努力をいたす所存でございます。今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。



# Top Message

当社グループを取り巻く環境は、米国景気の低迷や欧州の債務問題、新興国の景気減速感の高まり等により全般的に停滞感が強く、先行きについても依然として不透明な状況が続いています。半導体市場は、一般消費者向けを中心としたパソコン等の最終製品の需要減速により、一部に生産調整の動きも見られ軟調に推移しました。

こうした状況下、当社グループでは一丸となって売上拡大とコスト削減に努めたものの、当上半期の業績は、売上高14,631百万円（前年同期比9.3%減）、うち製品売上高14,462百万円（前年同期比9.1%減）となりました。また、利益面では、営業利益1,001百万円（前年同期比40.8%減）、経常利益1,022百万円（前年同期比40.9%減）、累計の四半期純利益688百万円（前年同期比39.3%減）となりました。

当社グループの主力となるシリコンウェハー向け製品につきましては、東日本大震災の影響による需要減少等によりラッピング材の売上高は1,685百万円（前年同期比11.8%減）、ポリシング材の売上高は3,892百万円（前年同期比0.5%減）となりました。

CMP向け製品につきましては、デバイスメーカーへの出荷が減少し、売上高は3,953百万円（前年同期比11.6%減）となりました。ハードディスク向け製品につきましては、従来型パソコンの低調な出荷状況などにより、売上高は912百万円（前年同期比42.3%減）となりました。

下半期については、冒頭申し上げたことに加え、タイの大洪水等もあり不安材料が多く、先行きは不透明であります。引き続き売上の拡大とコストの削減に注力してまいります。

当社が理想とする『強く、やさしく、面白い』会社の実現を目指して、企業風土そのものも見つめ直していく必要があると感じ、三年前から風土改革に着手しています。

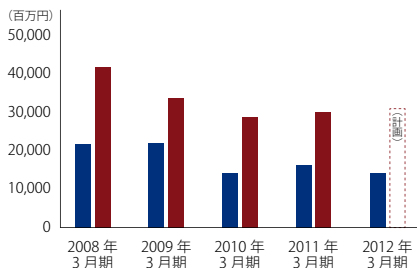
下半期も引き続きその動きを定着させ、より確かな動きとすることで、中長期経営計画の最初のステップである成長への基礎固め・体制づくりを完了させたいと思います。

また、次の柱となる新規事業の発掘・育成の動きも活発化させています。

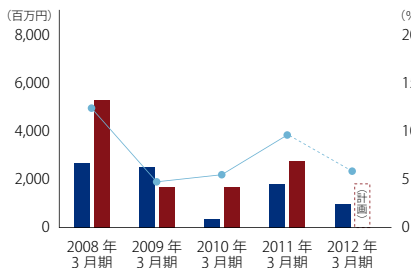
## 連結決算ハイライト

■ 上半期 ■ 通期 ● 実績 ● 計画

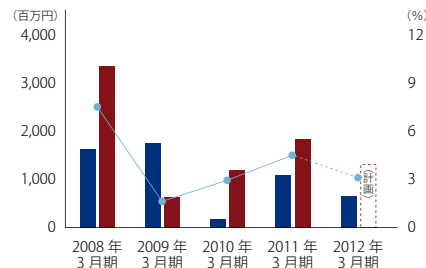
### ■ 売上高



### ■ 営業利益・売上高営業利益率



### ■ 上半期(当期)純利益・ROE



## 特集 1

# フジミの製品の優位性

## —高いシェアの要因—

フジミは創業以来、表面加工分野で世界のトップを走り続けています。

その要因をさまざまな角度から解説いたします。

フジミの製品が使用される分野、フジミの製品の必要性、世界におけるフジミの製品シェア、フジミの主要製品、フジミの製品の強さ、といったことを順を追ってご説明いたします。

特集1・2・3に掲載されている各製品写真はイメージです。

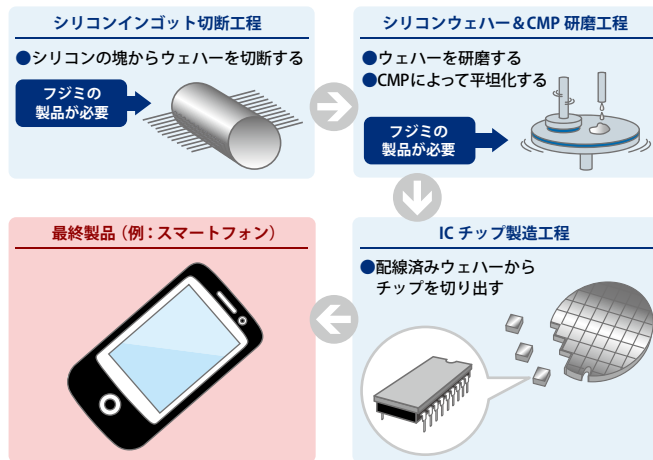
## 暮らしの基盤を支えるフジミの基板研磨製品

パソコンはもちろん、自動車、家電、携帯電話にいたるまで、さまざまな分野に使われているICチップ。最近では、**スマートフォン**やタブレット端末の登場もあり、その必要性がますます高まっています。

ICチップとは、**半導体**の性質を持つシリコン等でできたウェハーと呼ばれる薄い半導体基板の上に、複雑な電子回路を構築したものです。最近の家電には、省エネモードや節電モードなどの機能が搭載されていますが、そこでは電力使用をコントロールするために内蔵されたICチップが活躍しています。また、自動車も家電と同様にさまざまな機能がコンピュータにより制御され、そこにもたくさんのICチップが使われています。ICチップのニーズはいまや生活のあらゆる領域に及び、年率7%~8%の勢いで増え続けています。

フジミは、このICチップ製造に欠かせないシリコンウェハー等を磨く研磨材製品の提供を通じ、暮らしの基盤を支えています。

### フジミの製品が使われる工程の例



### スマートフォン

パソコンやPDA(携帯情報端末)の機能が備わった携帯電話。

### 半導体

電気を通しやすい導体と電気を通さない絶縁体との中間の性質を持つ物質。代表的なものにシリコンがある。

### ラッピング材

シリコン基板等を粗磨きするための粉末研磨材。

### ワイヤーソー

ワイヤーを使ってシリコンの塊を切断するのこぎりのような装置。

### ナノ

10<sup>9</sup>メートル=10億分の1メートル

## 世界的に高いシェアを誇る製品

精密研磨材の分野は、専門性が高いため、ノウハウと技術の蓄積がものをいいます。シリコンウェハー用**ラッピング材**の分野で、フジミが90%もの高い世界シェアを獲得しているのは、これまでにお客様の要求に対応してきた多くの開発実績があるからです。

半導体の基板となるシリコンウェハーは、シリコンインゴットと呼ばれるシリコンの塊を**ワイヤーソー**で輪切りにして作ります。このシリコンウェハーを精度よく切断するために、ワイヤーソー用の研磨材が使用されます。輪切りにされたシリコンウェハーの表面は視認できない位の凸凹な状態になっていますが、これを100万分の1mmの精度で平坦かつ滑らかに仕上げることが要求されます。なぜならば、シリコンウェハーの表面に**ナノレベル**で配線が施されるため、高度な研磨精度が必要だからです。このような高い研磨精度が要求されるシリコンウェハーの製造工程で使用される研磨材がラッピング材です。

フジミは、独自の技術を反映させることで、ラッピング材はもちろん、**ポリシング材**においても世界で高い評価をいただいています。鏡面研磨の工程は何回かに分けられ、シリコンウェハーの表面を配線に適した鏡面状態に仕上げます。とりわけ**ファイナルポリシング材**では89%という高いシェアを誇っています。

## 分野も、国境も越えて広がるフィールド

他社には真似のできない圧倒的な優位性。それは、フジミが半導体製造工程の川上から川下までを幅広くカバーしている世界でも稀な研磨材メーカーであるということ。あらゆる部材を磨くことに対しトータルに対応してきた経験が、周辺製品も含めた新製品の開発にも活かされています。

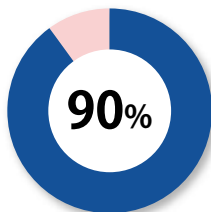
半導体をはじめとするハイテク関連業界は、より小さく、省エネで安く、高効率な製品づくりを目指しています。その結果、ICチップ製造は1枚のシリコンウェハーからより多くのチップをカットできるようにシリコンウェハーの**大口径化**が図られます。また、配線を平面から立体的に施す多層配線の方向へと向かっています。フジミではそうした新しい動きに対応した研磨剤や加工法の開発にも積極的に取り組んでいます。

また、近年、省エネの期待を集めるLED。その基材となる**サファイヤ基板**を磨く研磨剤や次世代の半導体基板として注目を集める**SiC(シリコンカーバイド)基板**用の研磨剤など新規分野の製品にも注力しています。さらに、台湾における研究開発・生産拠点の設立等、グローバルニーズに対応した組織展開も加速させています。

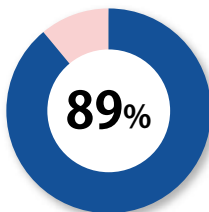
世界シェア (2011年9月末現在) ■フジミ ■他社

### シリコンウェハー用研磨材

#### ラッピング材



#### ファイナルポリシング材



(※自社推定)



フジミの製品群(一部)

#### ■ ポリシング材

ラッピング材よりもさらに細かな砥粒と薬液を配合した鏡面仕上げ用の研磨剤。

#### ■ ファイナルポリシング

何回かに分けられる鏡面研磨の工程における配線直前の最終鏡面研磨の段階。

#### ■ 大口径化

シリコンウェハーの直径は300ミリが現在の主流であり、450ミリも注目されている。

#### ■ サファイヤ基板

主にLED用として用いられる。シリコンより硬いため、研磨効率の向上が求められている。

#### ■ SiC(シリコンカーバイド)基板

シリコンに比べ、高電圧や高温に強く電力損失が少ないのが特徴。硬くて加工しにくい。

## 特集2

# フジミの製品の優位性 — 代表的な製品紹介 —

担当事業の責任者がフジミの主要製品の使用分野や特徴について解説します。



シリコン事業責任者：鈴木勝弘



CMP 事業責任者：青木利一郎



溶射材事業責任者：織田恒樹

## フジミの経験と技術から生まれた 精密ラッピング材

半導体素子を製造するためには、ウェハの表面を均一に加工しなければなりません。この最初の工程に欠かせない研磨材が精密ラッピング材です。厳選された材料を使用し、独自の製造工程によって粒子の形や硬度に特徴を持たせたのが、〈FO〉(Fujimi Optical Emery)をはじめとするオリジナルのラッピング材です。シリコンウェハはもとより、光学材料、水晶など、さまざまな用途に対応できる性能を持たせています。



精密ラッピング材 FO

ラッピング材は、フジミの研磨材の中でも主力製品のひとつですが、もともとはレンズやガラス等の光学材料用に開発された製品でした。のちにシリコンウェハに転用されるようになり、改良を加え、半導体の普及とともに大きくシェアを伸ばすこととなりました。世界でも圧倒的なシェアを誇るフジミのラッピング材。そこには、カメラやメガネを磨く光学レンズ用の研磨材から

スタートし、時代を先取りしながら事業の領域を広げ、多岐にわたる製品群を生み出してきたフジミの歴史とノウハウが息づいているのです。さらに、安定した研磨能力を確保するために、フジミでは、厳格な品質管理のもとで製造を実施するなど、つねに高いレベルを維持するための努力を続けています。



精密ラッピング材 A-WA



精密ラッピング材 GC-C

## ウェハの大口径化に対応した 鏡面研磨材

近年、半導体デバイスの高集積化やシリコンウェハの大口径化にともなって、シリコンの研磨面には、より高い精度の表面加工が要求されるようになってきています。

### 半導体素子

半導体を材料とする電気回路素子。集積回路(IC)、トランジスタ、ダイオードなどがある。

### 半導体デバイス

シリコンウェハなどの上に、微細な回路を形成した電子部品のこと。

〈GLANZOX〉は、ナノレベルの完全鏡面を実現するために開発されたポリシング材であり、**コロイダルシリカ**を特殊組成液に分散させることで、滑らかでムラのない完璧な研磨面を可能にしました。効率よく研磨を行うために、化学的な溶解除去作用を持つ液体と研磨のための**砥粒**を混ぜた**スラリー**として開発されています。また、デバイス特性に悪影響を及ぼす金属不純物に対する低減ニーズを踏まえ、高純度なコロイダルシリカを使用するなど、高い平坦性のもとより、重金属汚染フリーの完全鏡面を実現しています。



鏡面仕上げポリシング材 GLANZOX

## 半導体の多層配線を可能にする **ポリシング材**

半導体は生産性向上の要求から、ウェハーの口径は次第に大きくなっていますが、逆に配線幅は狭くなっていきます。それは、エレクトロニクス製品の小型化・高性能化のためには製品に搭載されるICチップを高集積化することが必要だからです。動画等の映像をスムーズに再生することや複雑な演算処理を素早くこなすこと、また、より小型化された商品を開発するためにICチップの高集積化は加速しています。結果、基板配線は微細化と多層化へ向かっていきます。

多層配線とは、従来は基板の平面に配線されていた状態を、薄い膜状に配線を施し、何層にも積み上げることにより、チップのサイズはそのまま、素子数を増やす技術です。最新のICチップでは、1円玉ぐらいの小さなチップの中に、髪の毛の直径の2000分の1という微細な配線層が12層程度



CMP用ポリシング材 PLANERLITE

### **コロイダルシリカ**

二酸化けい素の粒子径が10~300nmの微粒子状のもの。

### **砥粒**

研削、研磨に使用する高硬度の粒子。一般的なものに、アルミナ系と炭化ケイ素系がある。

積み上げられており、新聞紙おおよそ100万枚分の情報を収めることができます。

しかし、多層配線では配線を積み上げる際、各層の表面に少しでも凸凹があると配線不良が生じます。結果、電子回路が機能しなくなってしまうため、とりわけ厳しい原子レベルでの平坦化が求められます。この多層配線に使われる平坦化研磨技術が**CMP**と呼ばれる技術です。

フジミでは、高純度、高加工能率、高分散、スクラッチフリーを開発コンセプトとしたCMP用のポリシング材〈PLANERLITE〉を開発。シリコンウェハーの最終仕上げ材のノウハウを活かし、機械的研磨の作用を持つ微粒子（砥粒）に化学的研磨作用を持つケミカル成分を含んだ水溶液を分散・溶解等させるミキシング技術を確認しています。多層配線されたウェハーを効率良く研磨することができる高レベルな表面加工に対応しています。

## フジミの新たな市場開拓を代表する **溶射材**

フジミが手がける製品の中で、比較的新しいものに〈SURPREX〉などの溶射材があります。溶射材は、各種基材（部品）



溶射材料 SURPREX

の表面に皮膜を形成し、耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性等の機能を付加するために使用する材料です。鉄鋼、自動車、航空宇宙産業や半導体等のさまざまな分野で使われています。溶射は基材の耐久性を高め、寿命を延ばすことでコスト削減につながるだけでなく、環境負荷低減にも貢献します。フジミの溶射材は、精密研磨材で培った高い技術レベルと品質管理力に加え、技術サポート力を付加することでお客様のご要求に対しソリューションを提供いたします。

溶射は基材の耐久性を高め、寿命を延ばすことでコスト削減につながるだけでなく、環境負荷低減にも貢献します。フジミの溶射材は、精密研磨材で培った高い技術レベルと品質管理力に加え、技術サポート力を付加することでお客様のご要求に対しソリューションを提供いたします。

### **スラリー**

液体中に細かな固体粒子が混ざった状態のもの。

### **CMP**

Chemical Mechanical Polishingの略。薬液の化学的作用と砥粒の機械的研磨作用による平坦化技術。



# フジミの製品の優位性 —ここがフジミの強み—



## 1 ハイクオリティな研磨を可能にするテクノロジー

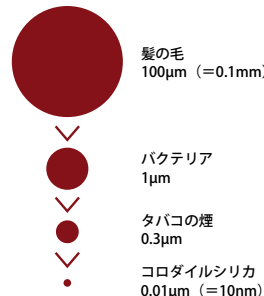
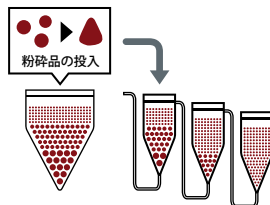
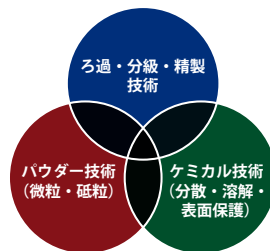
フジミの製品が世界で高いシェアを占めている理由のひとつは、「ろ過・分級技術」に卓越しているということ。最終研磨では、研磨剤の粒の中に1個でも大きな粒が入ると、そこに圧力が集中するため、キズの原因になりかねません。そこで、粒子のサイズを均一にする「ろ過・分級技術」が必要となります。また、フジミでは研磨や研削の段階で出た削りカスを分散させて、溶かす薬液などの「ケミカル技術」や研磨効率を高める「パウダー技術」にも力を入れています。

## 2 高度な「ろ過・分級技術」

研磨材のパウダーは、1ミクロン(1000分の1ミリ)単位で細かくクラス分けされており、研磨する対象物により粒の大きさも異なってきます。フジミでは、粒子の沈降速度の違いを利用した「湿式精密分級」と呼ばれる工程によってサイズ分けを実施。粉碎粒子を水中に分散させ、沈降速度と上向水流を調整することで、必要な粒子だけを静止させて取り出す分級方法を採用しています。

## 3 超微細な粒子を扱うエキスパート

フジミが扱う研磨剤の微粒子の中には、タバコの煙の粒子よりも小さなものもあります。コロidalシリカと呼ばれる粒子は、タバコの煙の粒子の30分の1、髪の毛の1万分の1という大きさです。そのようなミクロン単位以下の超微細な粒子を専門的に取り扱い、製品化していくのがフジミの技術。たとえば、何百億もの粒子の中から1~2個の大きな粒子を探し出すことも不可能ではありません。



### ケミカル技術

分散・溶解・表面保護などの機能を持つ薬液を設計・選定する技術。

### パウダー技術

用途に適した粒子を設計・選定・評価・製造する技術。

## NEWS

アジア戦略の拠点として、  
台湾に子会社を設立

台湾市場におけるCMP製品の積極的な拡販と技術支援、新規需要や顧客ニーズへの対応力強化等を目的として、今年8月に台湾子会社を設立しました。フジミでは、これまでもアジア地域のマレーシアに子会社を持ち、一部製品の製造・販売を行うとともに、台湾、上海、韓国に事務所を置いてきましたが、半導体分野におけるアジア拠点の重要性のさらなる高まりに対応するために台湾子会社の設立にいたしました。CMP製品の開発・製造・販売を通じて、売上拡大を目指してまいります。



完成イメージ図

## TOPICS 溶射材事業において、JIS Q 9100の認証を取得

- 今年9月、溶射材事業において、航空・宇宙・防衛品質マネジメントシステム「JIS Q 9100:2009」の認証を取得しました。
- JIS Q 9100は、品質マネジメントシステムの国際規格ISO 9001をベースに、航空宇宙産業特有の要求事項を盛り込んだ国際規格IAQS 9100の日本規格です。2000年に新規事業として活動をスタートした溶射材事業では、かねてより航空宇宙産業への本格参入を目指してきました。今回の認証取得を受けて、厳しい品質管理が求められる航空宇宙産業においても、お客様に満足していただけるように、品質のより一層の向上に努めてまいります。



# 用途別の動き

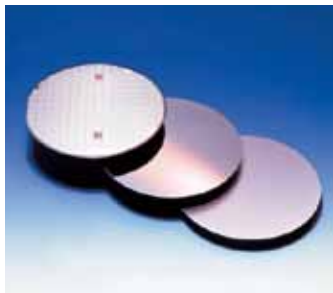
暮らしを楽しく、便利にするパソコン、スマートフォン、液晶テレビなどのデジタル家電。この心臓部に使用されている半導体部品の土台がシリコンウェハ（半導体基板）です。このウェハをいかに高精度に鏡面研磨できるかが、エレクトロニクス製品の性能を大きく左右する重要なポイントです。フジミは、人造研磨材の専門メーカーとして、シリコンウェハや半導体デバイスの製造工程に欠かせない研磨の分野で、人々が快適に暮らせる未来の創造に貢献していきます。



## シリコンウェハ用

- 売上高：5,578百万円
- 前年同期比：7.3%減

パソコンを中心に、電子・IT関連機器の心臓部に使用されている半導体部品の土台がシリコンウェハ（半導体基板）です。このウェハをいかに高精度に鏡面研磨できるかが、エレクトロニクス製品の性能を大きく左右します。当社の主力事業であるシリコンウェハ用製品では、お客様の期待に応える商品開発をタイムリーに行い、品質の高い新製品をいち早く市場に投入してまいります。



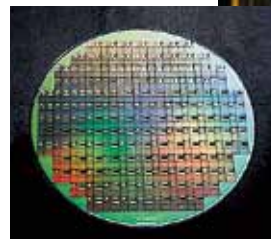
半導体の基板であるシリコンウェハ。現在の主流は、直径300mmの大口径となり、表面を高精度に磨き上げるために当社の超精密研磨材が使われています。

## CMP用

- 売上高：3,953百万円
- 前年同期比：11.6%減

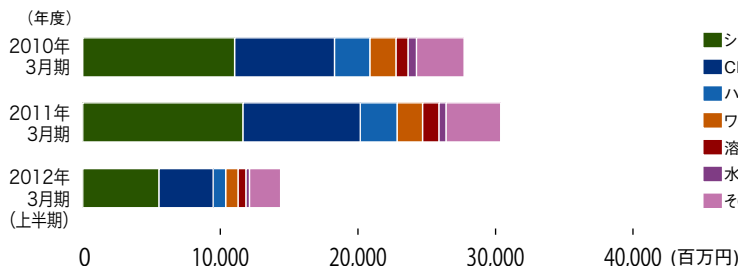
エレクトロニクス製品の小型化とともに高機能化・高性能化が急速に進み、半導体チップはますます高集積化・微細化が求められています。CMP（化学的機械的平坦化）用製品群は、長年にわたるシリコンウェハ用ファイナルポリシング材のノウハウを応用し開発され、多層配線技術に対応しています。お客様のロードマップにあった迅速な開発品の提供や技術サービスを核に、マーケットシェアの拡大を目指してまいります。

さまざまな情報通信機器やエレクトロニクス製品の技術進展が加速する中、半導体チップはますます小さく、その配線は細かくなっています。肉眼では見えない細かな配線は今では10~12層にも積み上げられ、その製造過程において、CMP研磨は欠かせずことができます。

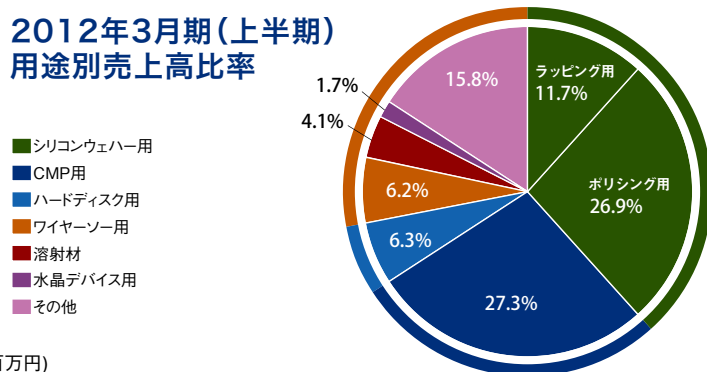


## 用途別製品 売上高推移

※グラフは商品を含めない自社製品のみで売上高です。



## 2012年3月期(上半期) 用途別売上高比率



### ハードディスク用

- 売上高: 912百万円
- 前年同期比: 42.3%減

ハードディスクは、パソコンの記憶装置としてはもちろん、ブルーレイディスク(BD)/DVDレコーダー、デジタルビデオカメラ、携帯音楽端末、カーナビなどにも搭載されています。デジタル家電の高機能化に伴い、プログラムやデータの高速読み出しが可能な小型・大容量のハードディスクの需要が高まり、ディスクの表面研磨は、シリコンウェハー同等もしくはそれ以上の面精度が要求されています。各業界のニーズをいち早くキャッチし、開発期間の短縮化によりお客様の要求にあった新製品をタイムリーに提供してまいります。



写真や映像を手軽に加工したいという市場ニーズが高まり、技術革新が進んだことで、パソコン、デジタルカメラ、携帯電話などのデジタル家電は、より多くの情報が記憶できるようになりました。それに伴い、記憶装置であるハードディスクの研磨面にも今まで以上の高いレベルが求められています。

### ワイヤーソー用、溶射材、水晶デバイス用、その他の用途

- 売上高: 902百万円(ワイヤーソー用)
- 前年同期比: 5.2%減
- 売上高: 586百万円(溶射材用)
- 前年同期比: 1.0%増
- 売上高: 243百万円(水晶デバイス用)
- 前年同期比: 12.7%減

ワイヤーソー用砥粒は、単結晶・多結晶のシリコンインゴット(塊)を厚さ1ミリ未満のウェハーに切断するために使用され、主にシリコンウェハーの切断や太陽電池用シリコンの切断に使われています。

溶射材は鉄鋼、航空機および半導体等さまざまな業界の溶射用途向けに、主にサーメット溶射材とセラミック溶射材を提供しています。開発力を強化し、新規高機能品の早期市場投入やタイムリーなソリューションの提案により、売上の大幅拡大とともに、収率改善や生産技術力の向上を図ってまいります。

その他製品は品質の維持向上や納期の迅速化、新用途の探索や新たな提案等でおお客様の信頼を高めてまいります。

# 連結財務諸表

(単位：百万円)

連結損益計算書	2011年3月期 (通期)	2011年3月期 (上半期)	2012年3月期 (上半期)
●売上高	30,869	16,137	14,631
売上原価	21,362	11,085	10,254
販売費及び一般管理費	6,729	3,360	3,375
●営業利益	2,777	1,691	1,001
営業外収益	125	65	77
受取利息／配当金	57	29	31
その他	68	35	46
営業外費用	85	28	57
支払利息	12	7	3
その他	72	21	53
経常利益	2,817	1,729	1,022
特別利益	54	53	2
特別損失	107	22	2
税金等調整前上半期(当期)純利益	2,764	1,760	1,022
法人税、住民税及び事業税	828	455	299
法人税等調整額	97	160	25
少数株主利益	17	10	8
●上半期(当期)純利益	1,820	1,134	688

※通期は4月1日から翌年3月31日まで。上半期は4月1日から9月30日まで。

## 売上高

半導体市場は、パソコン等の最終製品の需要減速により、一部に生産調整の動きも見られ軟調に推移した結果、売上高は前年同期比9.3%減の14,631百万円となりました。

## 営業利益

売上高の減少に加え、研究開発費の増加などにより、営業利益は前年同期比40.8%減の1,001百万円となりました。

## 上半期純利益

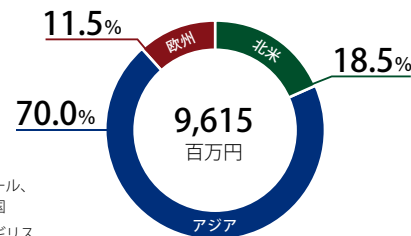
営業利益の減少の他、為替差損の増加や特別利益の減少があったものの、法人税なども減少したことから前年同期比39.3%減の688百万円となりました。

	2011年3月期 (上半期)	2012年3月期 (上半期)
海外売上高	9,839	9,615
連結売上高	16,137	14,631
連結売上高に占める割合	61.0%	65.7%

## 海外売上高構成比 (2012年3月期上半期)

※各区分に属する地域の主な内訳は次のとおりです。

- 北米：アメリカ、カナダ
- アジア：台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、韓国、中国
- 欧州：ドイツ、イタリア、イギリス



(単位：百万円)

(単位：百万円)

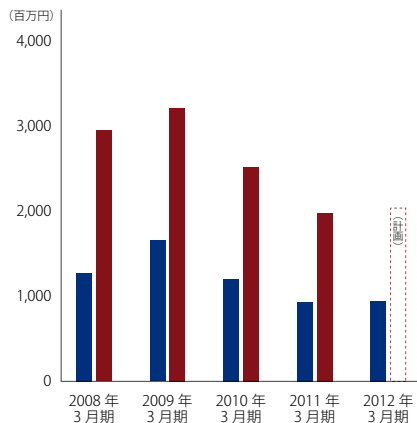
連結貸借対照表	2011年3月期 (通期)	2011年3月期 (上半期)	2012年3月期 (上半期)
<b>資産の部</b>			
流動資産	30,396	31,276	30,324
現金及び預金	12,468	15,321	10,847
受取手形及び売掛金	6,820	8,041	7,093
たな卸資産	5,048	4,935	5,768
その他	6,216	3,102	6,775
貸倒引当金	△157	△123	△160
固定資産	16,338	16,844	15,991
有形固定資産	13,919	14,392	13,581
無形固定資産	305	320	298
投資その他の資産	2,113	2,131	2,111
資産合計	46,734	48,121	46,315

※通期は年度末の3月31日現在。上半期は9月30日現在。

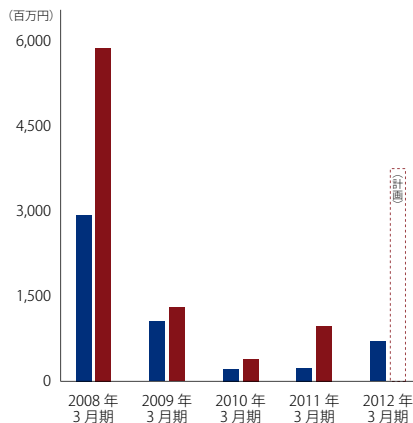
連結貸借対照表	2011年3月期 (通期)	2011年3月期 (上半期)	2012年3月期 (上半期)
<b>負債の部</b>			
流動負債	5,714	5,970	5,922
支払手形及び買掛金	2,905	3,672	3,519
短期借入金	81	88	76
その他	2,727	2,209	2,325
固定負債	217	254	172
負債合計	5,932	6,225	6,095
<b>純資産の部</b>			
株主資本	42,100	42,873	41,931
資本金	4,753	4,753	4,753
資本剰余金	5,069	5,069	5,069
利益剰余金	36,069	35,815	36,274
自己株式	△3,792	△2,764	△4,166
その他の包括利益累計額	△1,565	△1,243	△1,968
新株予約券	61	61	60
少数株主持分	205	203	198
純資産合計	40,802	41,895	40,220
負債純資産合計	46,734	48,121	46,315

■ 上半期 ■ 通期 ● 実績 ● 計画

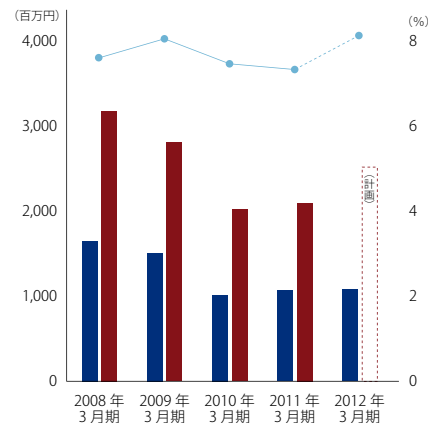
## ■ 減価償却費



## ■ 設備投資額

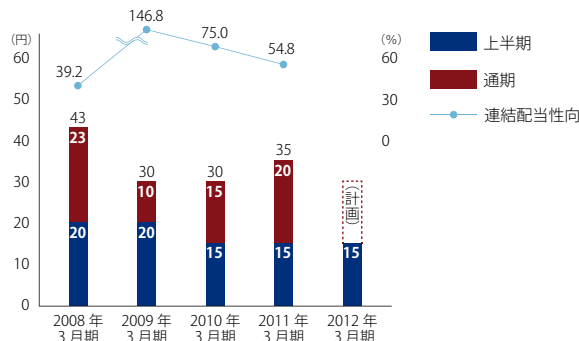


## ■ 研究開発費・対売上高比率



連結キャッシュ・フロー計算書	2011年3月期 (通期)	2011年3月期 (上半期)	2012年3月期 (上半期)
●営業活動によるキャッシュ・フロー	4,342	2,278	189
税金等調整前上半期(当期)純利益	2,764	1,760	1,022
減価償却費	1,991	962	909
売上債権増減額(△は増加)	1,036	△ 62	△ 229
仕入債務増減額(△は減少)	△ 289	397	632
たな卸資産増減額(△は増加)	△ 561	△ 327	△ 857
その他	173	10	△ 770
小計	5,115	2,740	705
利息及び配当金の受取額	68	38	29
補助金の受取額	—	△ 8	—
法人税等の支払額	△ 837	△ 500	△ 540
その他	△ 4	9	△ 4
●投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 471	354	△ 1,167
定期預金の預入による支出	△ 1,505	△ 501	△ 2,008
定期預金の払戻による収入	1,500	1,000	1,505
有形固定資産の取得に関する支出	△ 508	△ 205	△ 617
無形固定資産の取得に関する支出	△ 63	△ 42	△ 48
その他	106	103	1
●財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,073	△ 571	△ 977
短期借入金の純増加(減少)額	△ 87	△ 91	—
長期借入金の純増加(減少)額	△ 87	△ 45	△ 39
自己株式の取得による支出	△ 1,028	—	△ 373
親会社による配当金の支払額	△ 862	△ 431	△ 558
その他	△ 7	△ 3	△ 5
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 171	△ 78	△ 327
現金及び現金同等物の増加(減少)額	1,626	1,983	△ 2,282
現金及び現金同等物期首残高	14,639	14,639	16,265
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	—	—	155
現金及び現金同等物期末残高	16,265	16,623	14,139

※通期は4月1日から翌年3月31日まで。上半期は4月1日から9月30日まで。



### 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べて2,089百万円減少し、189百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の減少及びたな卸資産の増加により資金の減少があったことによるものです。

### 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は、1,167百万円となりました。これは主に、定期預金の預入による支出及び有形固定資産の取得による支出が増加したこと等によるものです。

### 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動に結果使用した資金は、前年同期に比べて406百万円増加し、977百万円となりました。これは主に、自己株式の取得による及び配当金の支払による支出が増加したこと等によるものです。

### 配当金及び連結配当性向の推移

当社は、株主に対する適正な利益還元を行うことを経営の重要課題と認識し、配当につきましては、安定配当にも留意し30%以上の連結配当性向を目標として、業績に応じた積極的な株主還元に取り組んでまいりました。このような方針のもと、当期末配当金は1株につき15円とし、年間配当金は、1株につき30円を予定しています。

# 株式情報 2011年9月30日現在

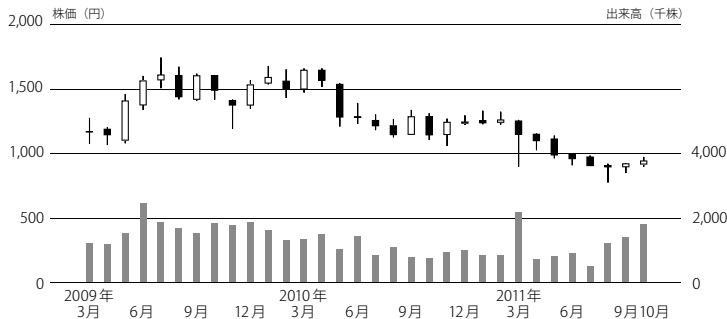
## 株式の状況

株式数	発行可能株式総数	120,000 千株
	発行済株式総数	30,699 千株
	株主数	7,296 名

## 大株主 (株主名) 持株数 (千株) 持株比率 (%)

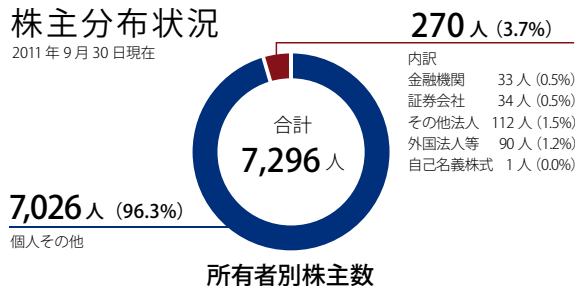
株式会社フジインコーポレーテッド (自己株口)	3,175	10.3
越山 勇	2,902	9.4
有限会社コマ	1,638	5.3
野田 純孝	1,520	4.9
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	1,186	3.8
越山 彰	1,151	3.7
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	1,064	3.4
日本生命保険相互会社	779	2.5
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	728	2.3
株式会社リそな銀行	691	2.2

## 株価および出来高の推移

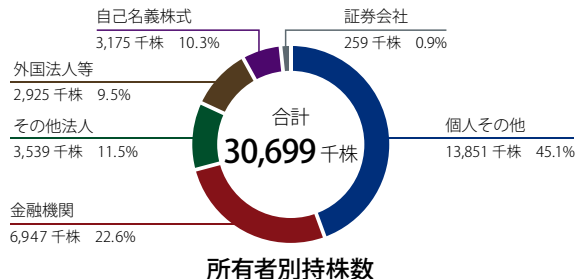


## 株主分布状況

2011年9月30日現在



### 所有者別株主数



### 所有者別持株数

## 役員

2011年  
9月30日現在

代表取締役社長	関 敬史
取締役	土屋太加志
取締役	伊藤 広一
取締役	鈴木 彰
常勤監査役	石井 和廣
常勤監査役	松島 伸男
監査役	鮎澤 多俊
監査役	高橋 正彦

## 会社データ

2011年9月30日現在

商 号	株式会社フジインコーポレーテッド
証 券 コ ー ド	5384
本 社 所 在 地	愛知県清須市西枇杷島町地領 2-1-1 TEL. 052-503-8181 (代表)
設 立 年 月 日	1953年 (昭和 28年) 3月 20日
資 本 金	47億 5,343万 8,500円
代 表 者	代表取締役社長 関 敬史
従 業 員	773名 (個別 597名)

# 株主メモ

2011年9月30日現在

決算日	3月31日
基準日	3月31日
単元株式数	100株
公告方法	電子公告 ( <a href="http://www.fujimiinc.co.jp">http://www.fujimiinc.co.jp</a> ) ただし、事故その他やむを得ない事情によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載することといたします。
株主名簿管理人	〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先 および照会先	〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711 (フリーダイヤル)

## 各種手続のお申出先

- 支払期間経過後の配当金のお支払いについては、株主名簿管理人にお申出ください。
- 住所変更、単元未満株式の買取、配当金受取方法の指定等  
証券会社をご利用の株主様は、お取引の証券会社へお申出ください。  
証券会社をご利用でない株主様は、特別口座の口座管理機関である日本証券代行株式会社へお申出ください。

### 【ご注意】

特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、日本証券代行が口座管理機関となっておりますので、下記特別口座の口座管理人に、お問合わせください。

特別口座管理機関 日本証券代行株式会社  
連絡先 〒137-8650  
東京都江東区塩浜二丁目8番18号  
電話 0120-707-843  
(フリーダイヤル)

## 株式会社フジミインコーポレーテッド

お問い合わせ先：経営企画部企画課  
TEL：052-503-8181 (代表)  
URL：<http://www.fujimiinc.co.jp>

Copyright (C) 2011 Fujimi Incorporated. All rights reserved.



古紙/古プ配合率9%再生紙を使用

森林認証紙

適切に管理された森林から  
切り取られた木材を使用しています

この印刷物は、環境負荷低減のため適切に管理された認証パルプと古紙パルプを5%以上使用した環境対応紙と、植物油を使用し、VOCの排出を抑えた環境対応型リサイクルインキ「ベジタブルインキ」を使用しています。